

2025年7月31日

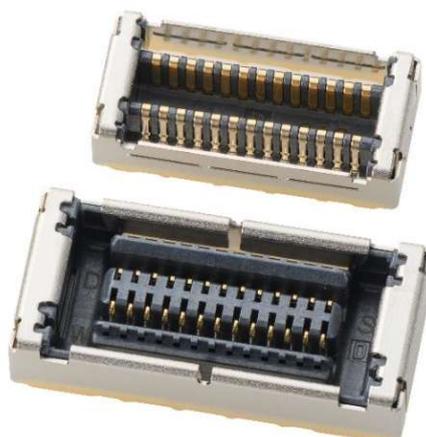
記者各位

京セラ株式会社

京セラ初のフルシールド構造^{※1}で EMI 特性^{※2}の向上と高速伝送を実現 0.4mm ピッチ基板対基板コネクタの新製品「5908 シリーズ」販売開始

※1 コネクタのプラグ側とリセプタクル側、それぞれの外周を導電性の金属で覆った構造
※2 Electromagnetic Interference：電磁妨害（干渉）に対する発生量や耐性の特性

京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫）は、このたび当社コネクタでは初めてフルシールド構造^{※1}を採用した 0.4mm ピッチ基板対基板（Board to Board）コネクタの新製品「5908 シリーズ」を製品化しました。当社は、電磁干渉を抑制することで EMI 特性^{※2}の向上を図りかつ高速伝送にも対応可能な本製品を、本日 7月 31日（木）より販売開始しますのでお知らせいたします。



5908 シリーズ

■5908 シリーズの主な特長

1. フルシールド構造^{※1}による優れた EMI 特性^{※2}で、高速伝送に対応
2. 独自のロック構造で保持力 30%向上の高い堅牢性を実現

近年、通信機能や情報処理能力の向上などにより、スマートフォンをはじめとする通信端末やスマートウォッチなどウェアラブルデバイスは、ますます高機能化が加速しています。それらの機器に搭載されるコネクタにおいては高速伝送時の EMI 特性^{※2}の向上が課題のひとつとなっています。

その課題を解決すべく、このたび京セラはフルシールド構造^{※1}を初めて採用し、ノイズの侵入や漏洩を最大限抑制することで、優れた EMI 特性^{※2}を有する 0.4mm ピッチ基板対基板（Board to Board）コネクタ 5908 シリーズを製品化しました。

■5908 シリーズの特長

1. フルシールド構造^{※1}による優れた EMI 特性^{※2}で、高速伝送に対応

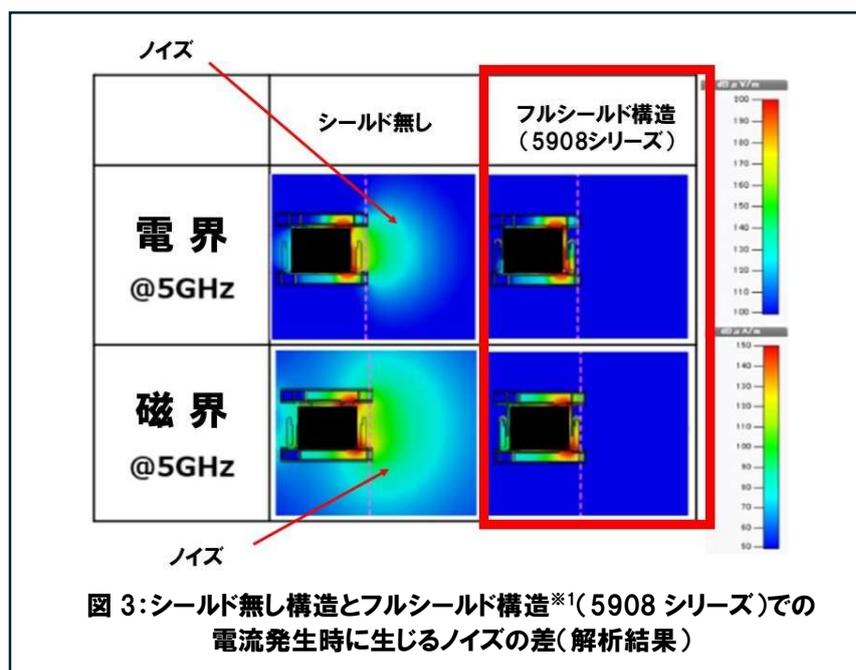
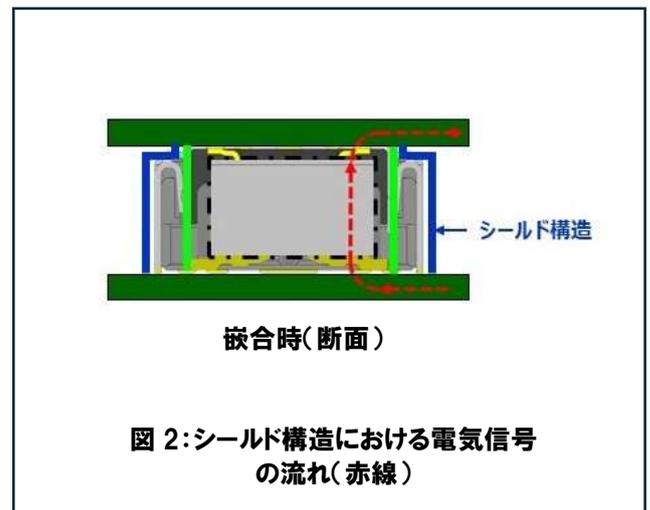
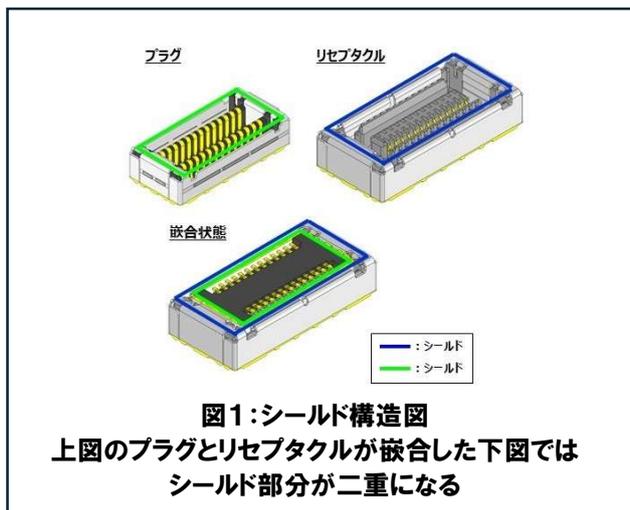
プラグ側とリセプタクル側、それぞれの外周を導電性の金属で覆ったフルシールド構造^{※1}を採用しました（図 1 参照）。フルシールド構造^{※1}は、コネクタの本体や接続部分が金属シェルによって外周を覆われているので、ノイズの侵入や漏洩を最大限抑制することができ、EMI 特性^{※2}を向上することが可能となります。本製品は嵌合時、二重シールド構造になり、電気信号の回路がシールドの内側を通ることで、ノイズの発生を抑制します（図 2 参照）。

<対応高速伝送規格>

PCI Express^{※3} Gen.3（8Gbps）、USB^{※4} 3.2 Gen.2（10Gbps）など

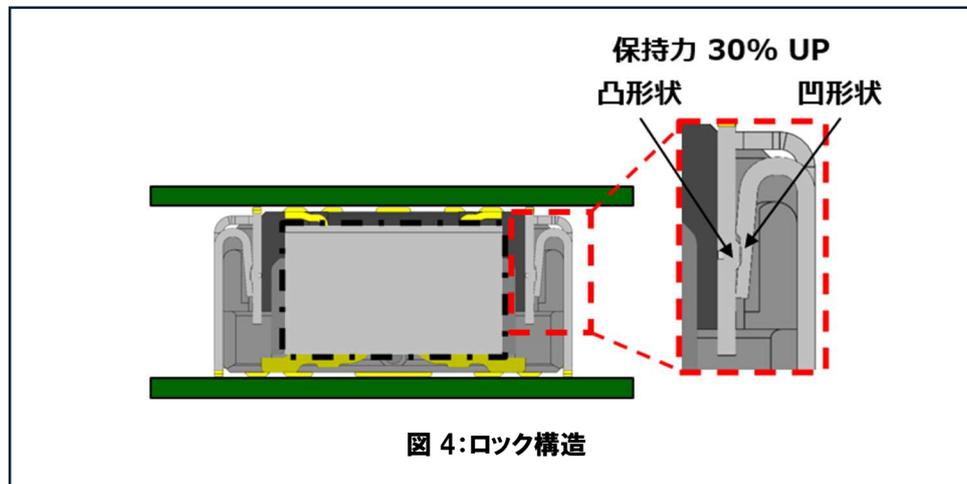
※3 PCI Express（PCIe）：パソコン内部の拡張カード（グラフィックボード、SSD など）とマザーボードを接続するための高速シリアルバス規格

※4 USB：パソコンと周辺機器（マウス、キーボード、ストレージなど）を接続するための汎用インターフェース



2. 独自のロック構造で保持力 30%向上の高い堅牢性を実現

プラグ側に凸形状、リセプタクル側に凹形状を施し、しっかりと嵌合できるロック構造とすることで、保持力が弊社従来品と比べ 30%向上する高い堅牢性を実現しました。また、プラグ側、リセプタクル側のそれぞれに嵌合時の誘い込みに効果的な R 形状を採用し良好な作業性を実現しています。



■5908 シリーズ製品概略

製品名	5908 シリーズ
ピッチ	0.4mm
製品サイズ	奥行: 4.2mm 嵌合高さ: 2.0mm
対応極数	20~50 極
使用温度範囲	-40°C~+125°C

■5908 シリーズの製品詳細:https://ele.kyocera.com/ja/technical/con_npi5908/

■ 報道機関からのお問い合わせ: 京セラ株式会社 広報室
本社 TEL:075-604-3514(直) / 東京 TEL:03-6364-5503(直)